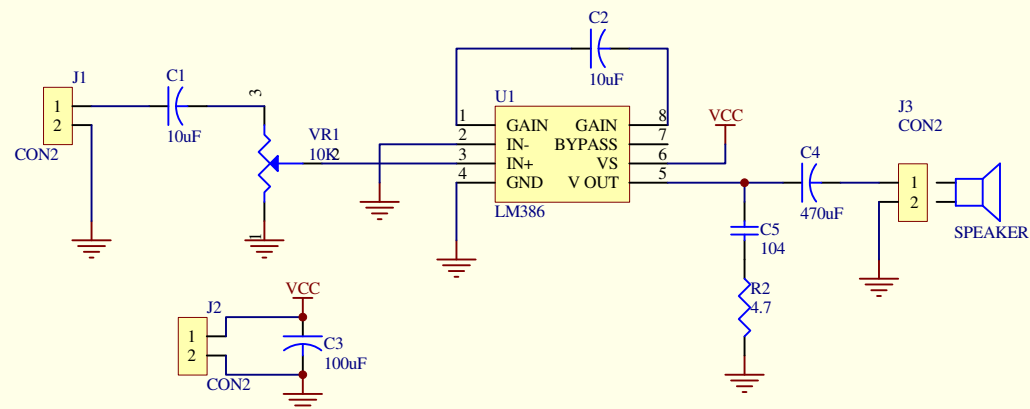


作り方
 こちらの基板はバージョン2.1です。基板の半田面よりバージョンを判断してください。
 バージョン2.1はカップリングコンデンサーを追加しました。
 カップリングが不要な場合C1をジャンパーしてください。
 背の低い部品から基板に挿入半田付けをします。
 基板の各部品パターンは1番ピンのランドは四角です。
 ICには方向性があります。半付け前に必ずご確認ください。
 ケミカルコンデンサーは極性がありますので、挿入時に必ず、基板をご確認ください。
 電源は4.5~12Vまで対応で数が9Vぐらいが望ましいです。
 また、車載は安全回路等が必要でお勧めいたしません。利用する場合、ヒューズ等安全回路を入れてください。
 責任でご使ください。
 C2はアンプの増幅率を決めます。基板作成時はC2を装着せず、音量不足を感じたらC2を装着してください。



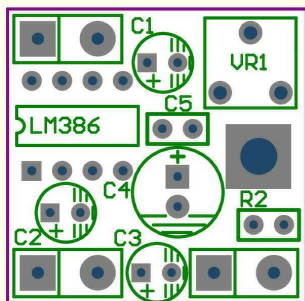
注意：車載は推奨いたしません。もし、車載や大電流電源接続の場合、必ずヒューズを挿入してください。

部品表

Used	Part Type	Designator
1	4.7	R2
1	10K	VR1
2	10uF	C1 C2
1	100uF	C3
1	104	C5
1	470uF	C4
1	LM386	U1

J1 信号入力

信号 GND



音量

J2

+ -

電源入力

J3

+ -

スピーカー

合資会社エフエーエル

Beans amplifier LM386
 LM386超小型汎用アンプV2.1

Size A4	FCSM No.	DWG No.	Rev
Scale	Sheet 0 of 0		